



ハイブリッド・アセンブリー

HYBRID ASSEMBLIES

HYBRID ASSEMBLIES

光電子では、半導体素子とその周辺回路、並びにユニット、完成品に致るまで一貫生産を行なう技術を駆使して、様々な素子製品、アッセンブリー製品を納めています。光半導体素子を中心に、各種組み合わせたもの（フォトインタラプタ、フォトカプラ等）発光のみ、受光のみの素子を等間隔あるいは必要位置に配置したもの（フォトダイオード、カスタムパターン素子）素子単体にケースを装着したもの、スズ引線、ビニール被覆線等リード処理したもの、さらにプリント基板、セラミック基板にマウントしたものなど、多種多様なアッセンブリーが可能です。また、個々の光半導体に動作制御回路、信号処理回路等の前処理、後処理回路を取り付けたもの、ユニット化したものについて、よりユーザーのニーズに合致したカスタム製品をお届けしています。

これらハイブリッド・アッセンブリー製品は、ユーザーの多品種少量生産、新規商品開発のニーズ（電気的特性、形状寸法、使用部品、数量、納期、価格）に対して着実に応えするとともに、一方では過去培われた技術を次々と導入し、高次の仕様変更を積極的に展開しています。

特長 FEATURES

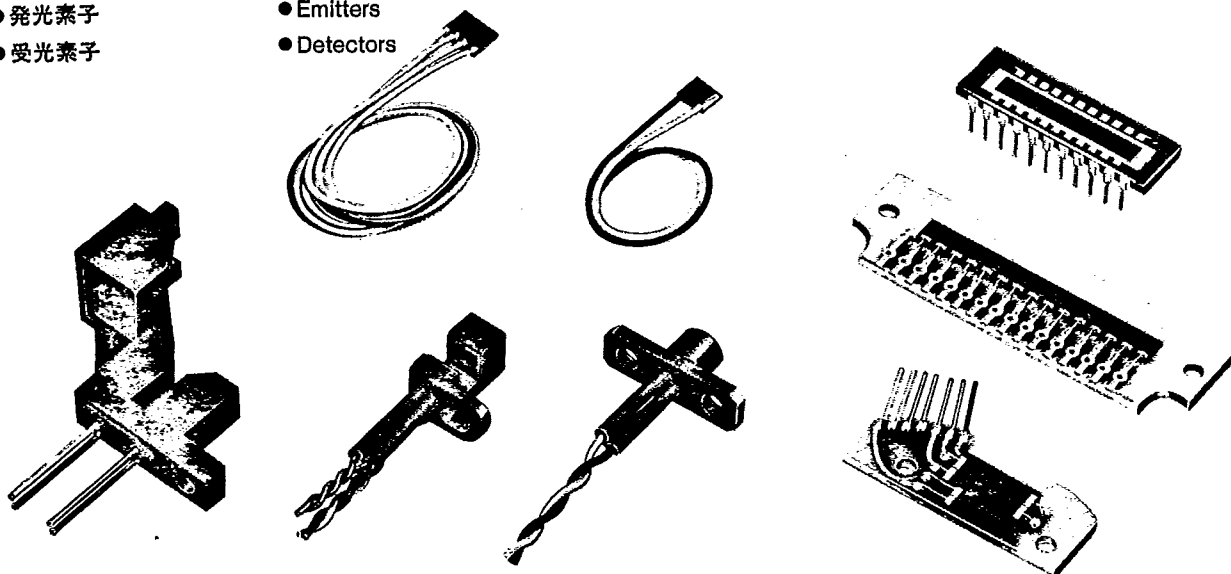
- ユーザーの新規商品に合った製品設計ができます。
- 使用材料の選定ができます。
- 複合アッセンブリーが可能です。（例 P.C.B.マウント+リード処理）
- We can provide the best design for your new products.
- You can choose whatever material you require.
- We can manufacture complex assemblies.
(e.g., Mounted on P.C.B. + Manufactured harness.)

アッセンブリー例

- インタラプタ
- フォトダイオードアレイ
- 発光素子
- 受光素子

Assemblies

- Photointerrupters
- Photodiode Arrays
- Emitters
- Detectors





ハイブリッドIC

HYBRID IC

HYBRID IC

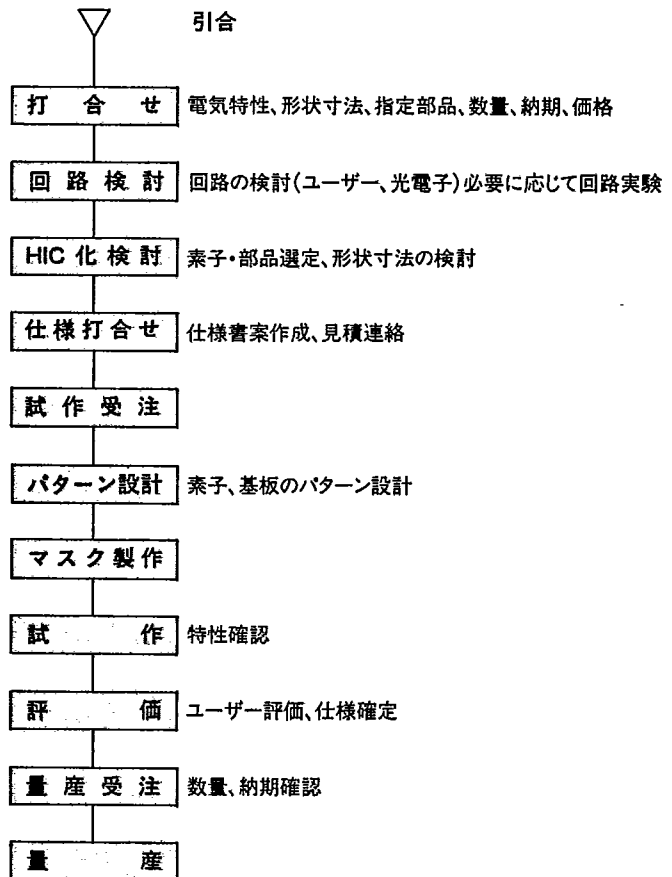
光電子ハイブリッドICは、従来から育んできた光センサーアッセンブリー技術とハイブリッドICアッセンブリー技術を結合させることによって、光センサー周辺回路の小型高密度実装を実現しました。光電子は、この独自のハイブリッド技術と独自のアッセンブリー進行管理のノウハウをもって、ユーザーの指定回路をハイブリッドIC化し、スピーディかつローコストに供給し、各種機器の小型化、高密度化に貢献しています。

例えば、フォトダイオードアレイ等のセンサーを搭載したフォトハイブリッドICは、光素子の実装によって、光センサー機能を持っています。さらにその信号処理回路をあわせもつことによって、部品点数の削減、組立工程の簡略化といったメリットを生み出します。

特長 FEATURES

- 集積度を高め、小型化が可能です。
- ユーザーでの工程管理（部品調達、組立、検査、在庫管理）が大幅に省略出来ます。
- プランニングの段階からあらゆる要求に応えます。
- 膜抵抗、リードレス部品の使用により、はんだ付け箇所が減少し、信頼性を向上できます。
- 使用材料の選定が可能です。
- Highly integrated; compact.
- We simplify your manufacturing process.
- We answer every need from planning to completion.
- Use of film resistor and leadless parts lessens number of soldering points, improves reliability.
- You can choose whatever material you require.

■設計



●回路例

